UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KARAKTERISTIK WETTABILITY PADA BAHAN SOLDER BERTIMBAL (Sn-37Pb) DAN TANPA TIMBAL (Sn-3Ag-0,5Cu)
Yanuar Ashari, Ir. I Gusti Bagus Budi Dharma S.T., M.Eng. Ph.D. IPU. ASEAN.Eng
Universitas Gadjah Mada, 2013 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3. Bahan solder tanpa timbal yang telah ditemukan sudah banyak, pengujian pada bahan solder tanpa timbal dengan paduan lain misalnya Sn-Ag-Bi dan Sn-Zn perlu dicoba untuk mendapatkan alternatif bahan solder tanpa timbal.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KARAKTERISTIK WETTABILITY PADA BAHAN SOLDER BERTIMBAL (Sn-37Pb) DAN TANPA TIMBAL (Sn-3Ag-0,5Cu)
Yanuar Ashari, Ir. I Gusti Bagus Budi Dharma S.T., M.Eng. Ph.D. IPU. ASEAN.Eng
Universitas Gadjah Mada, 2013 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A.D. Romig, Jr., Y.A. Chang, J.J. Stephens, Etal., 1991, Physical Metallurgy Of Solder-Substrate Reactions, Solder Mechanics,The Minerals, Metals, and Materials Society, P30-32.

ASM Handbook Vol. 6, 1993, Welding, Brazing, and Soldering, ASM International.

Charles, H.K., Sinnadurai, N, 1999, Rising to The Environmental Challenge, The John Hopkins University USA & TWI Cambridge UK, *IMAPS Proceeding*, 7-9 June, P 78

Dušek, Miloš, dkk, 2011, Wettability – SnPb and Lead-free, Materials Centre National Physical Laboratory, Middlesex, UK.

Gupta, M., dkk., 2005, Influence of Ceramic Reinforcements On The Wettability and Mechanical Properties of Novel Lead-Free Solder Composites, Elsevier B.V., Singapore.

Pan, J, Toleno, B, J, dkk, ____, Effect of Reflow Profile on SnPb and SnAgCu Solder Joint Shear Force, California.

Seelig, K, Suraski, D, 2003, A Comparison of Tin-Silver-Copper Lead-Free Solder Alloys, AIM, Rhode Island, USA

Strauss, Rudolf, Dr.Ing., FIM, 1998, SMT Soldering Handbook, 2nd edition, Newnes, Woburn, MA.

Tyas Rini S, 1998, Analisis Kadar Timah Hitam Dalam Darah dan Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Enzim Delta Aminolevulinic Acid Dehydratase dan Kadar Hemoglobin Dalam Darah Karyawan Di Industri Peleburan Timah Hitam,Universitas Padjadjaran, Bandung.

T. Zednicek, P. Vasina, Z. Sita, B. Vrana, Lead-Free Soldering Effect On Tantalum Capacitors, AVX Coorporation, Lanskroun, Czech Republic.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KARAKTERISTIK WETTABILITY PADA BAHAN SOLDER BERTIMBAL (Sn-37Pb) DAN TANPA TIMBAL (Sn-3Ag-0,5Cu)
Yanuar Ashari, Ir. I Gusti Bagus Budi Dharma S.T., M.Eng. Ph.D. IPU. ASEAN.Eng
Universitas Gadjah Mada, 2013 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wardhayani S, 2006, Analisis Risiko Pencemaran Bahan Toksik Timbal (Pb) Pada Sapi Potong Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Jatibarang Semarang, Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang

Xu, Dong-Xia, dkk, 2007, Experimental Wettability Study of Lead-Free Solder on Cu Substrates Using Varying Flux and Temperature, Beijing, China.